



決算説明会

2014年 3月期

2014年 5月2日

ローム株式会社 澤村 諭

AGENDA

■ 2014年3月期 業績報告

■ 2015年3月期 業績見込

■ ロームの戦略

- ・ 分析
- 1. 市場改革
- 2. 商品改革
- 3. 構造改革
- 4. 研究開発
- 5. 設備投資

■ 株主還元

■ LSIの事業戦略

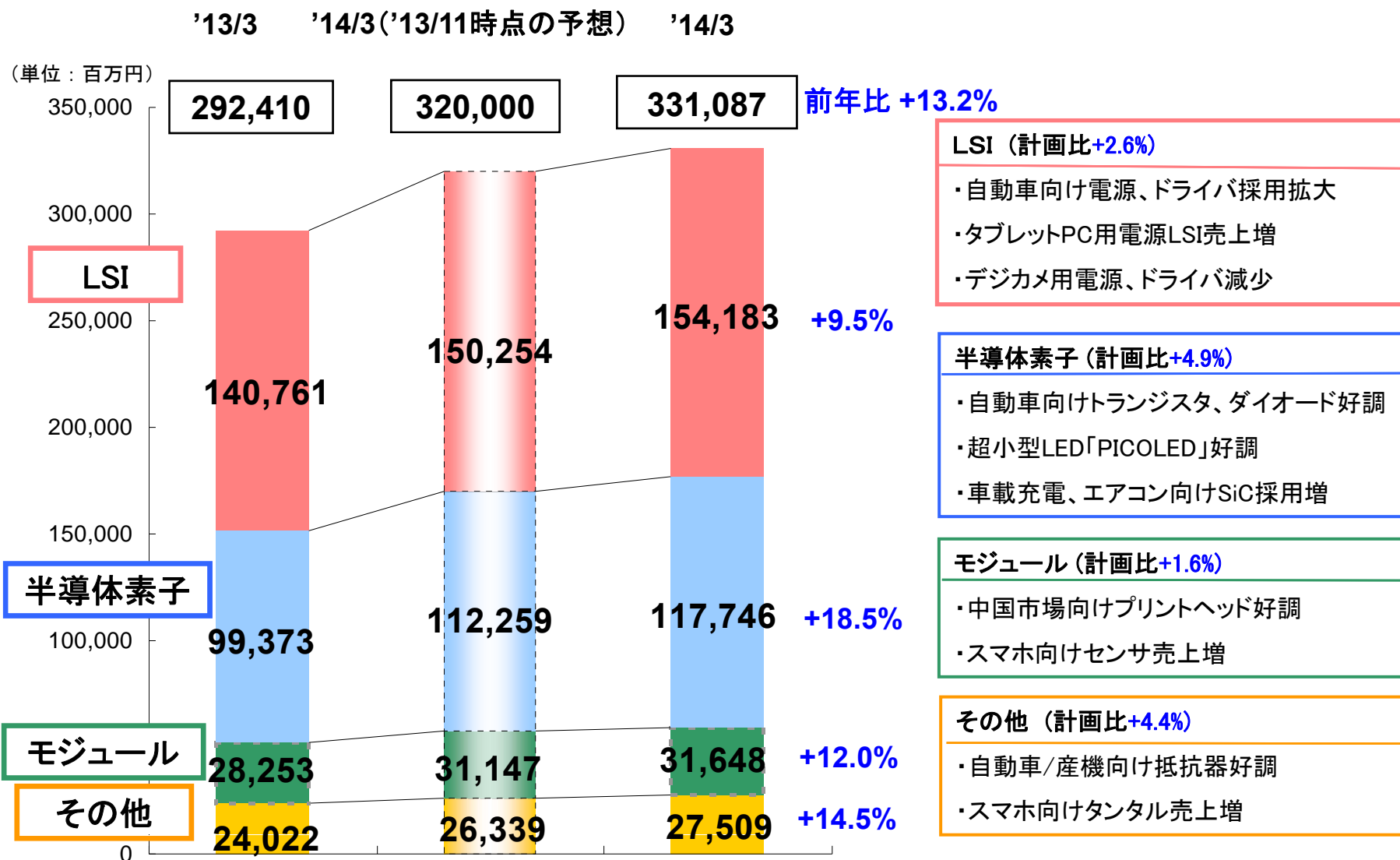
■ ディスクリート・モジュールの事業戦略

2014年3月期 業績報告

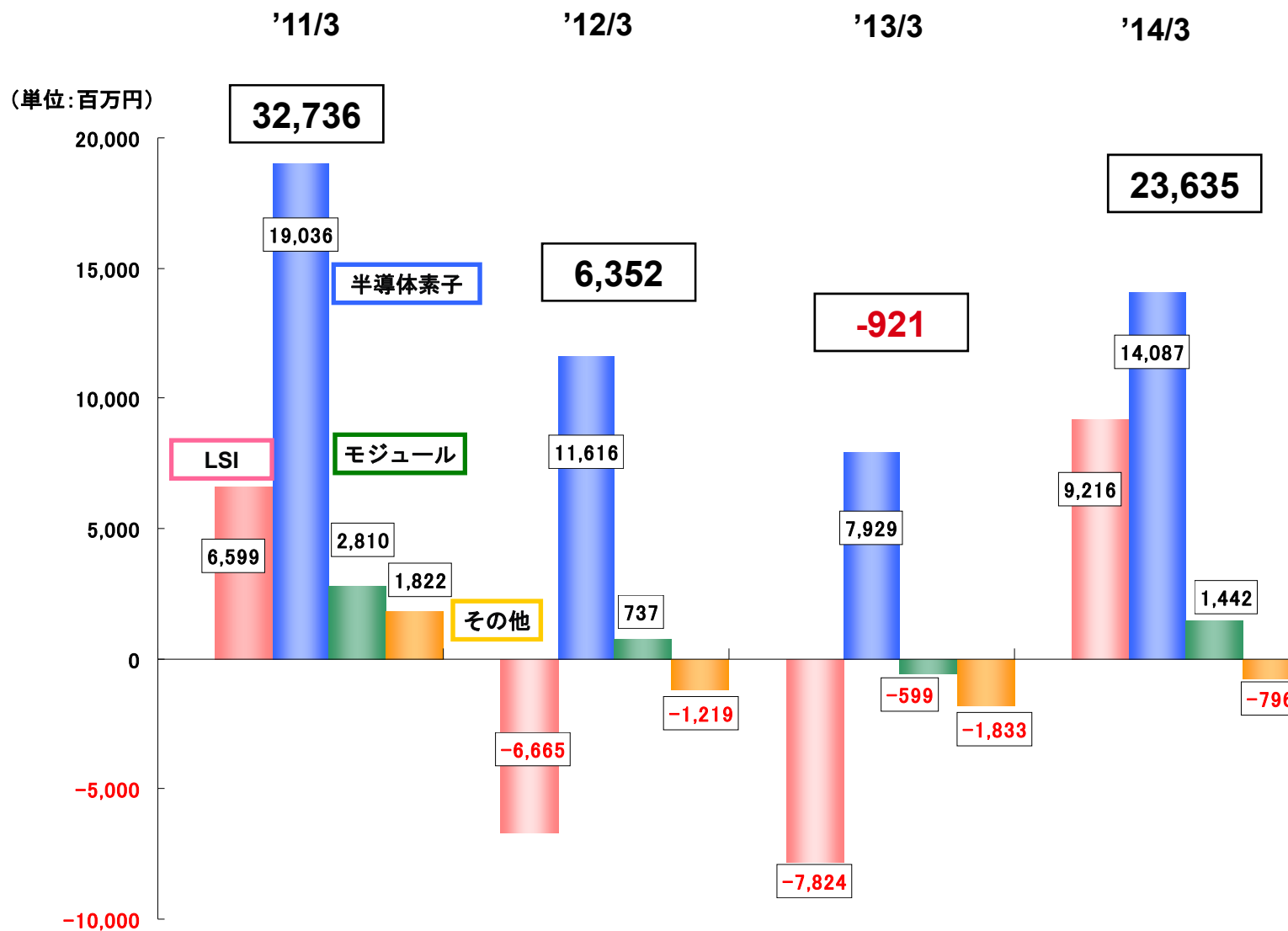
(単位:百万円)

	'13/3期 実績	'14/3期 実績	増加額	前年比
売上高	292,410	331,087	+38,677	+13.2%
営業利益	▲ 921	23,635	+24,556	(黒字転換)
(対売上比率)	(▲ 0.3%)	(7.1%)	—	—
経常利益	11,786	35,915	+24,129	+204.7%
(対売上比率)	(4.0%)	(10.8%)	—	—
当期純利益	▲ 52,464	32,091	+84,555	(黒字転換)
(対売上比率)	(▲ 17.9%)	(9.7%)	—	—
EBITDA	37,958	49,194	+11,236	+29.6%
(対売上比率)	(13.0%)	(14.9%)	—	—
期中平均レート (¥/US\$)	(83.2)	(100.0)		

製品別売上実績（前年比）



セグメント別利益推移

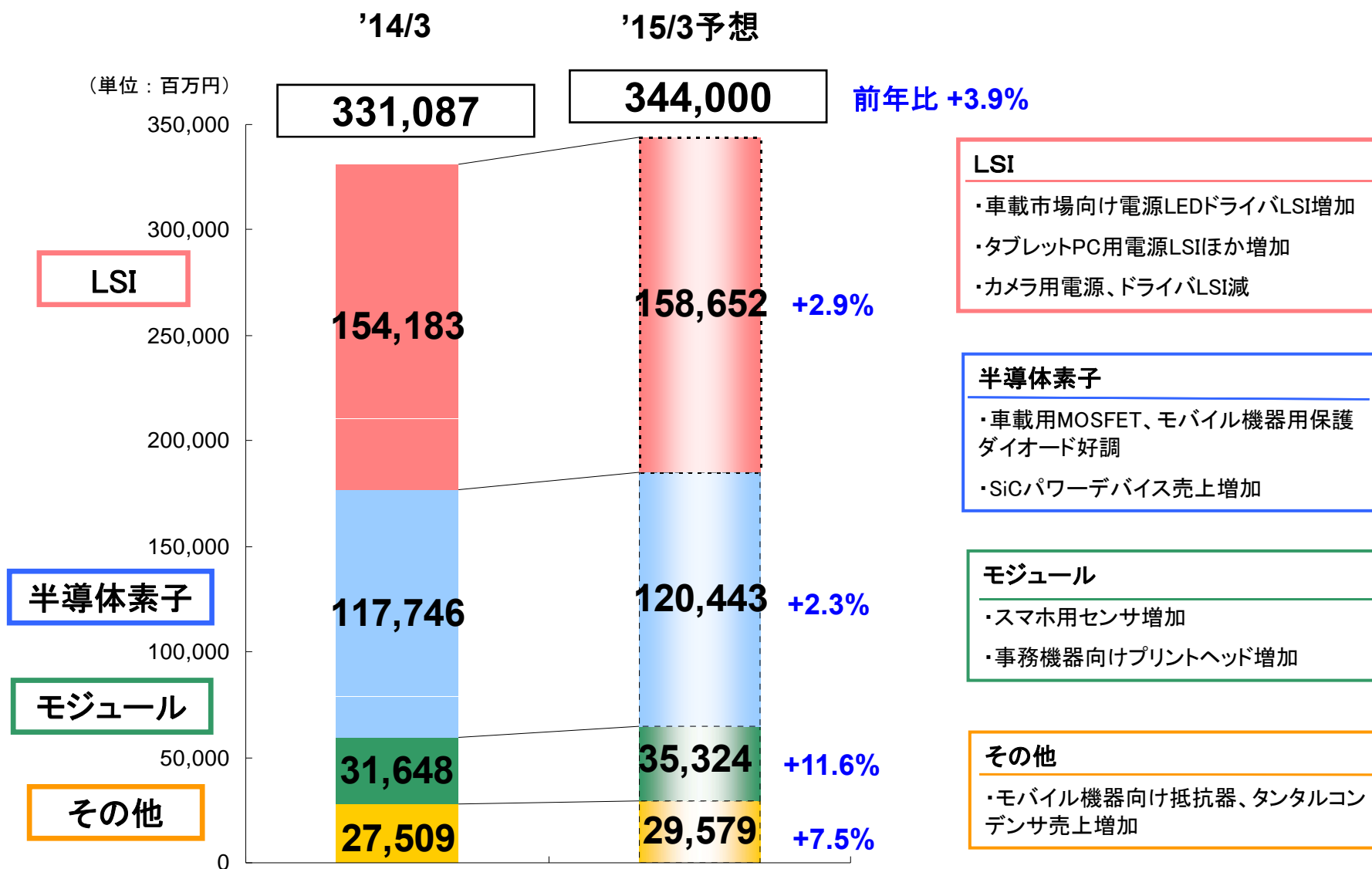


2015年3月期 業績見込

(単位:百万円)

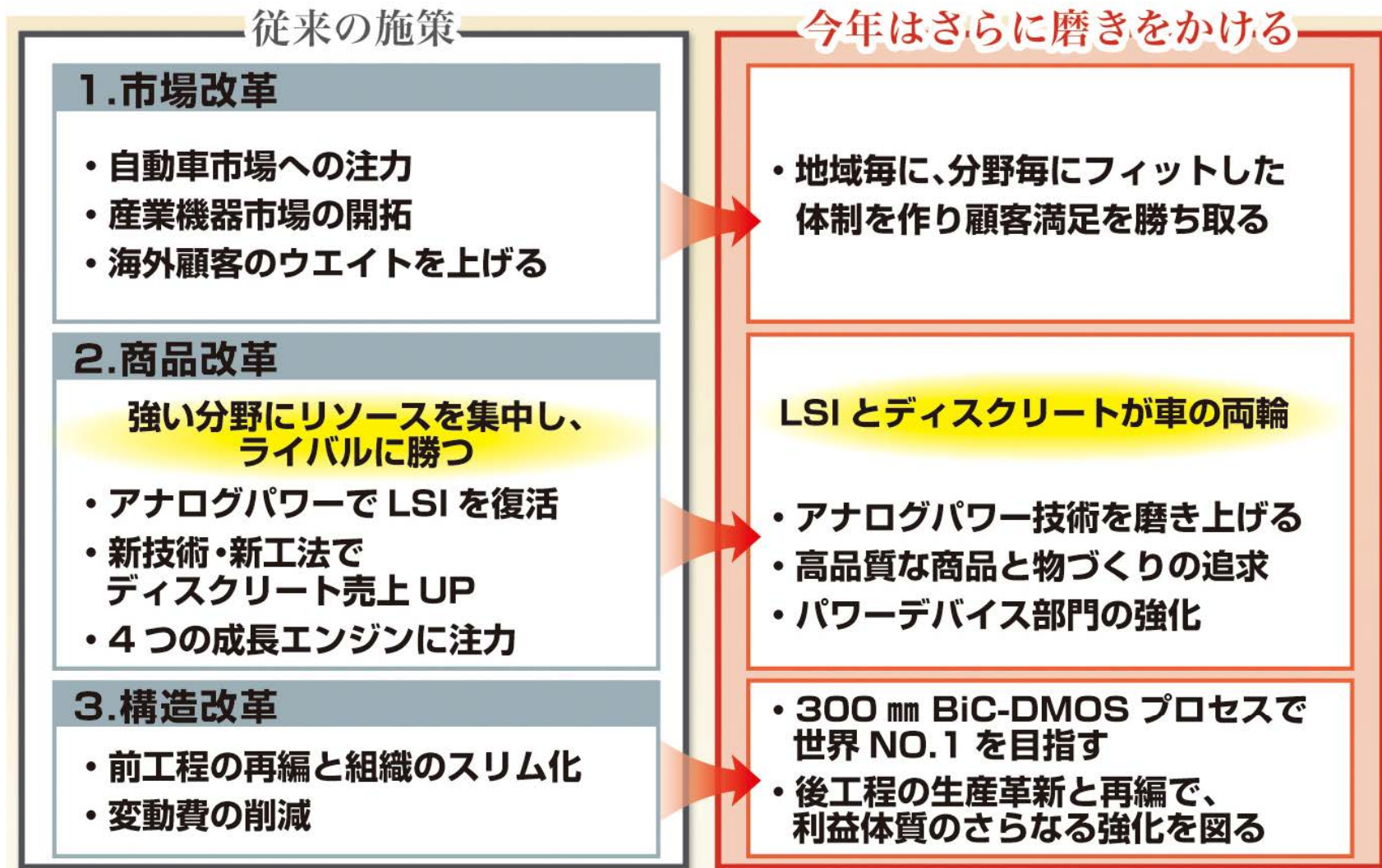
	'14/3期 実績		'15/3期 予想		
	金額	前年比	金額	増加額	前年比
売上高	331,087	+13.2%	344,000	+12,913	+3.9%
営業利益	23,635	(黒字転換)	25,500	+1,865	+7.9%
(対売上比率)	(7.1%)	—	(7.4%)	—	—
経常利益	35,915	+204.7%	25,500	▲10,415	▲29.0%
(対売上比率)	(10.8%)	—	(7.4%)	—	—
当期純利益	32,091	(黒字転換)	21,000	▲11,091	▲34.6%
(対売上比率)	(9.7%)	—	(6.1%)	—	—
EBITDA	49,194	+29.6%	63,500	+14,306	+29.1%
(対売上比率)	(14.9%)	—	(18.5%)	—	—
期中平均レート (¥/US\$)	(100.0)		(100.0)		

製品別売上計画（実績比）



ロームの戦略

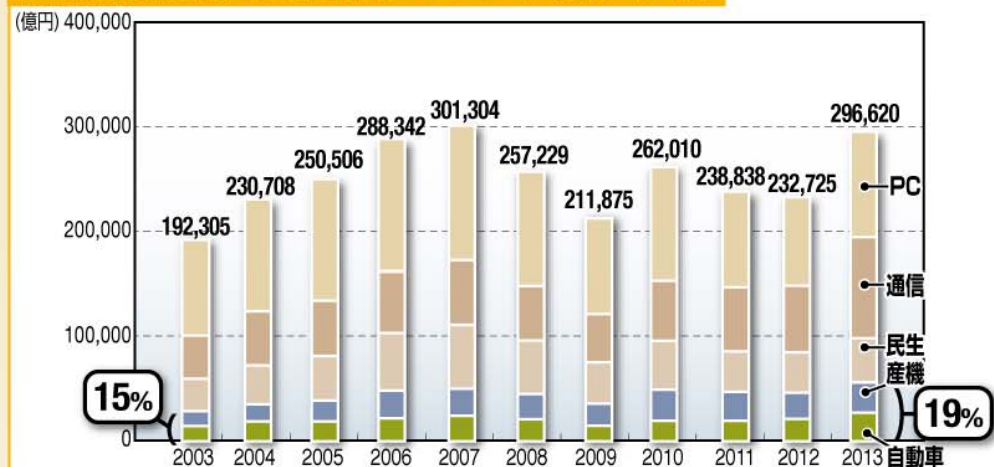
従来の施策を踏襲し、強化する



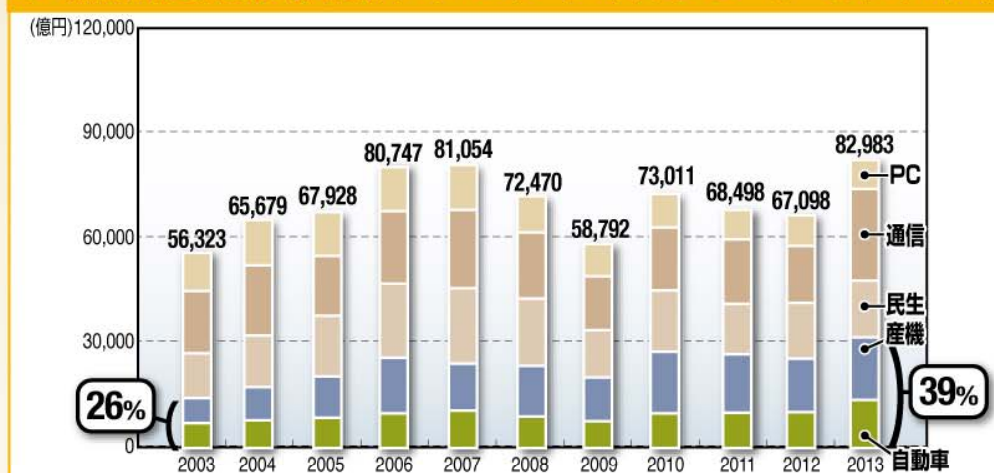
ロームの戦略

分析 ① 需要の変化(我々が自動車・産機市場に注力する理由)

市場別需要推移(対象:全ての半導体市場)

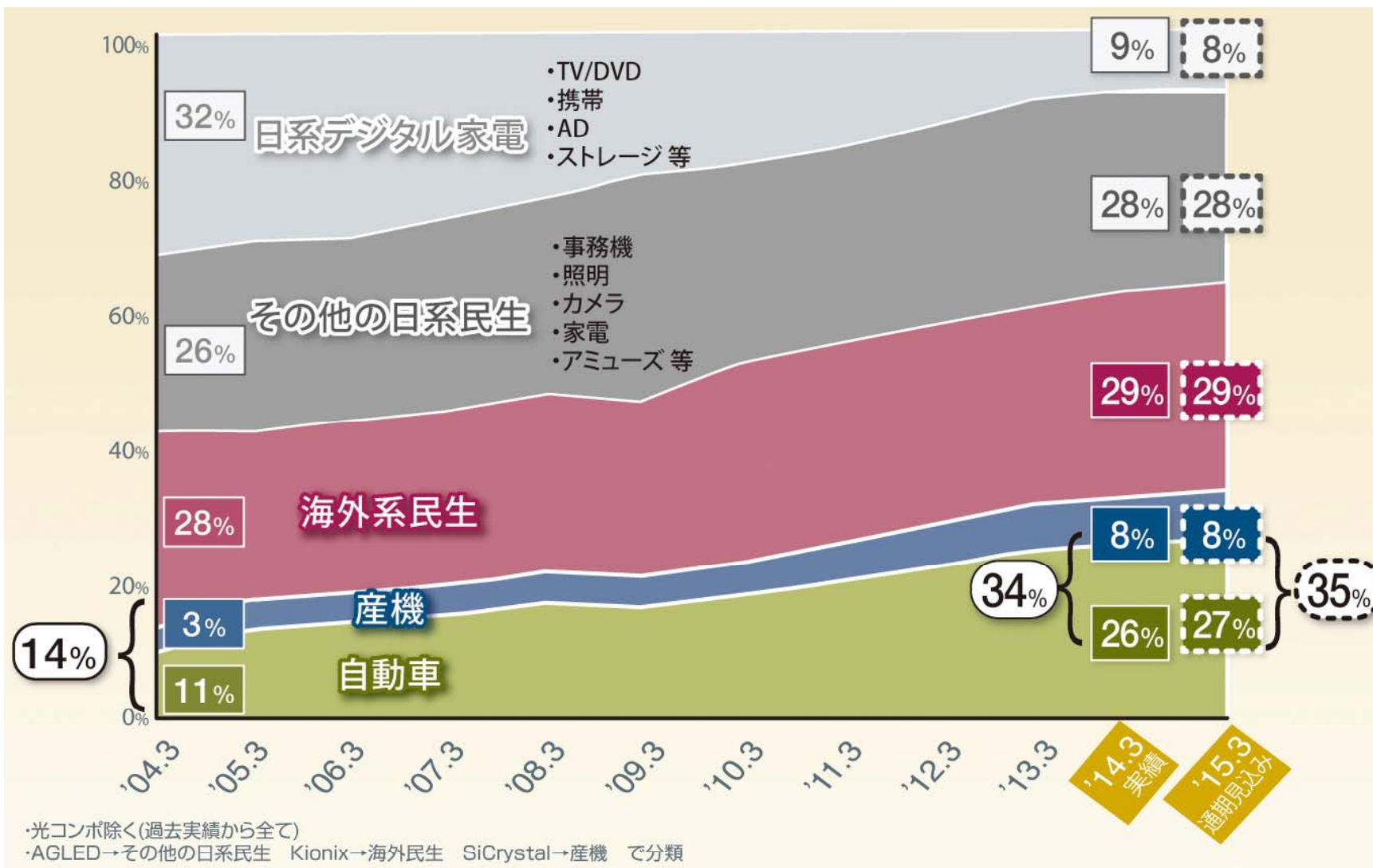


市場別需要推移(対象:アナログ・ディスクリート・オプト市場)



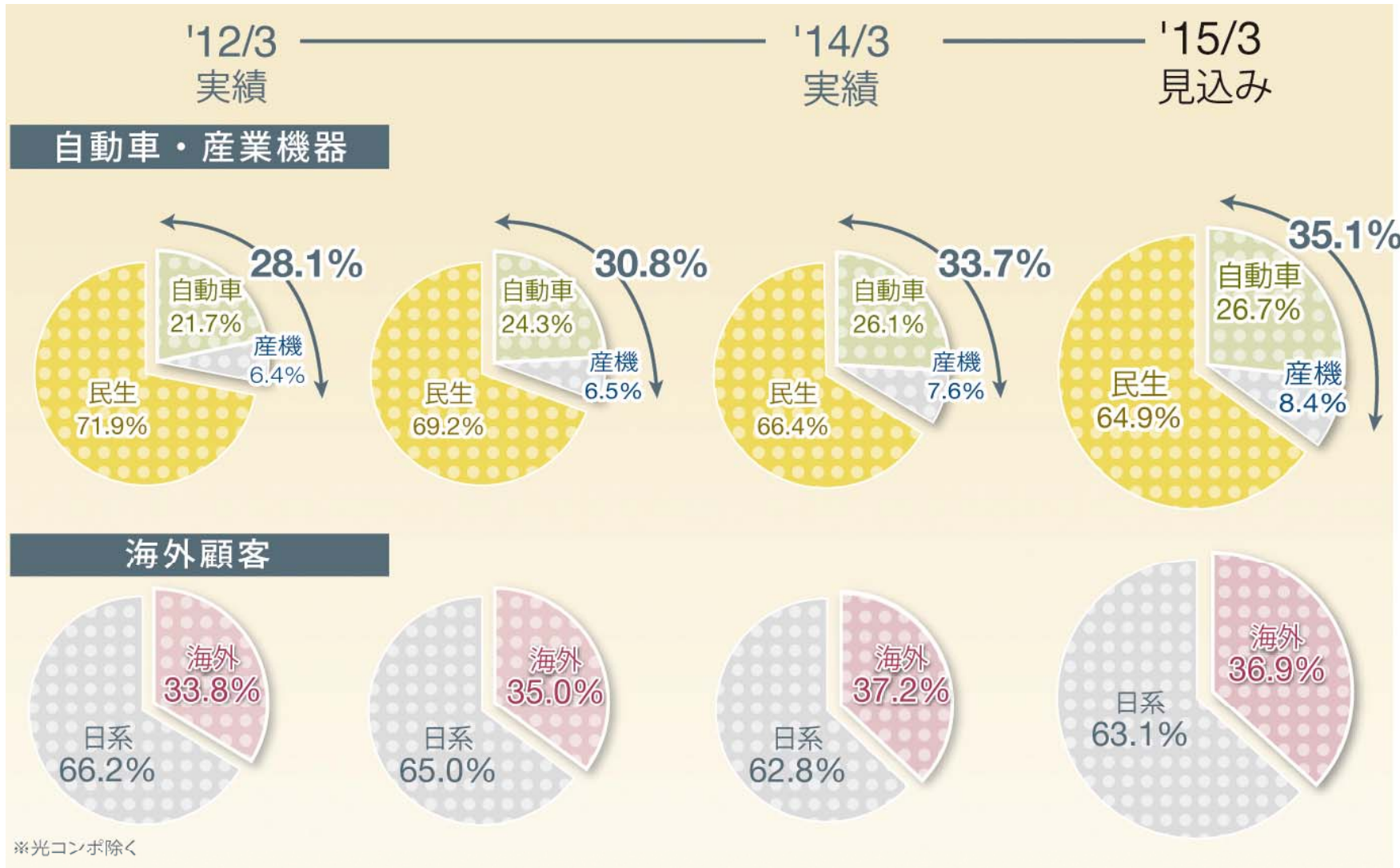
ロームの戦略

分析 ② 11年間の市場別販売比率の推移



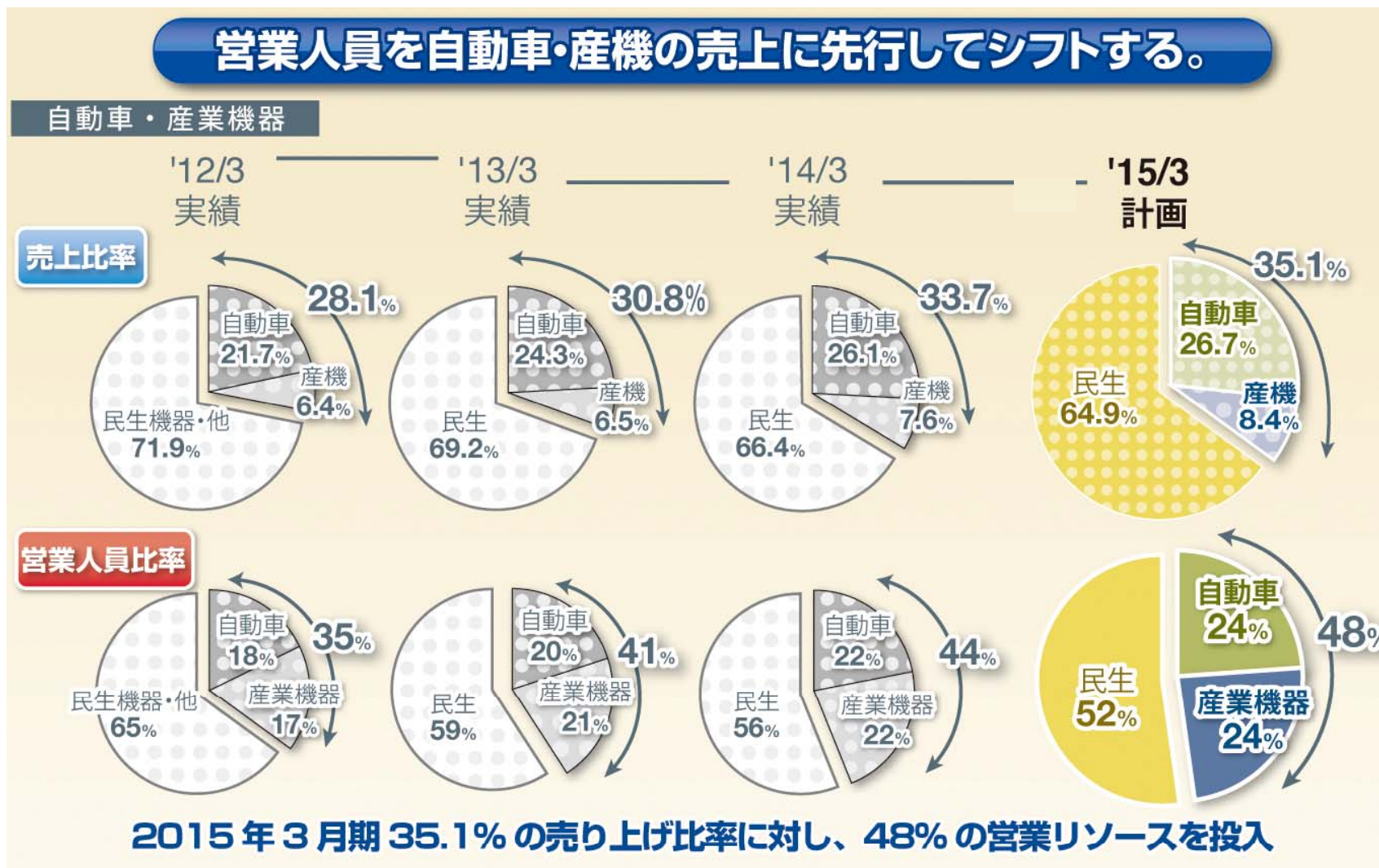
ロームの戦略

分析 ③ 4年間の市場別販売比率の推移



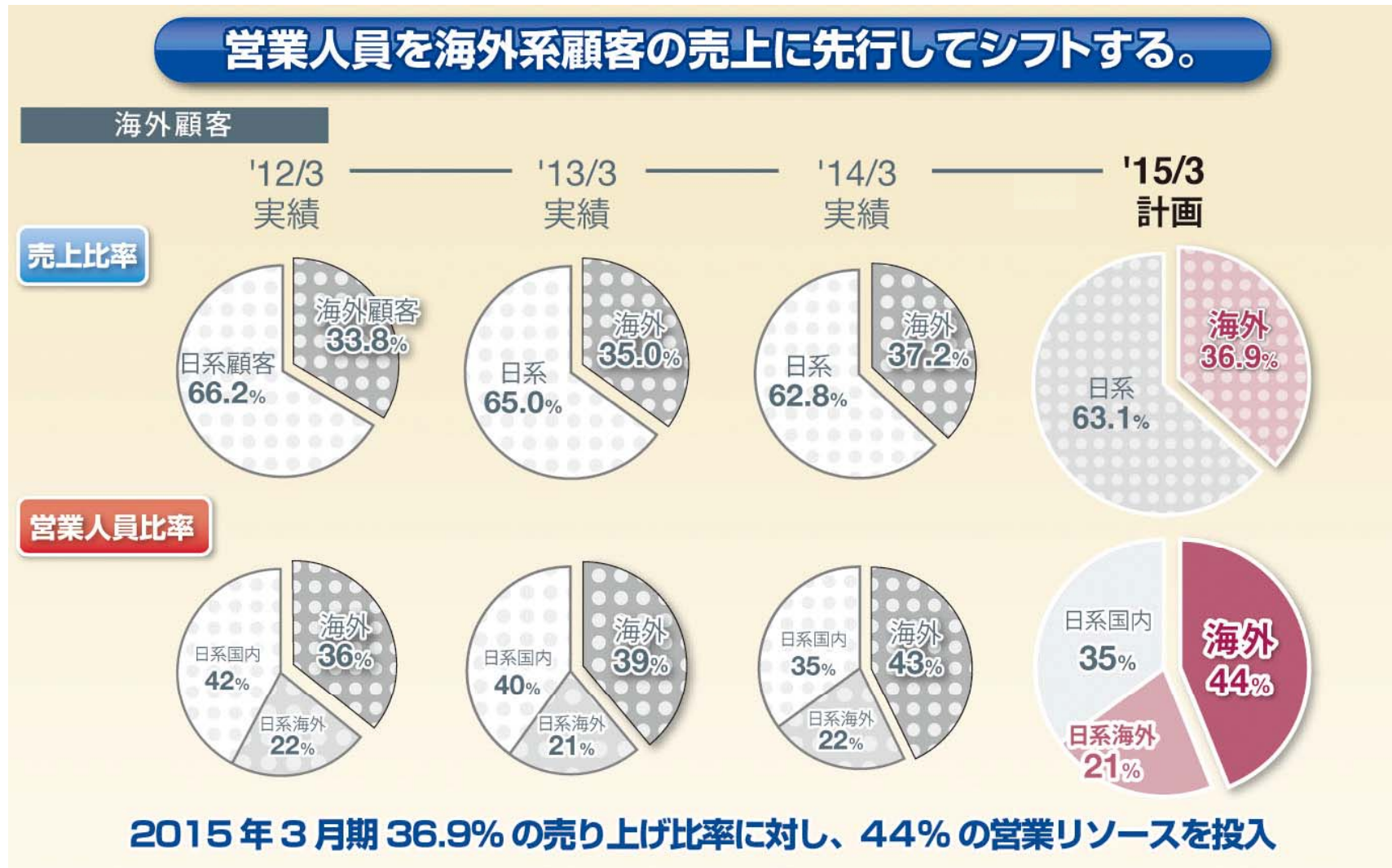
ロームの戦略

1. 市場改革 ①営業サポート体制をシフト(自動車・産機市場)



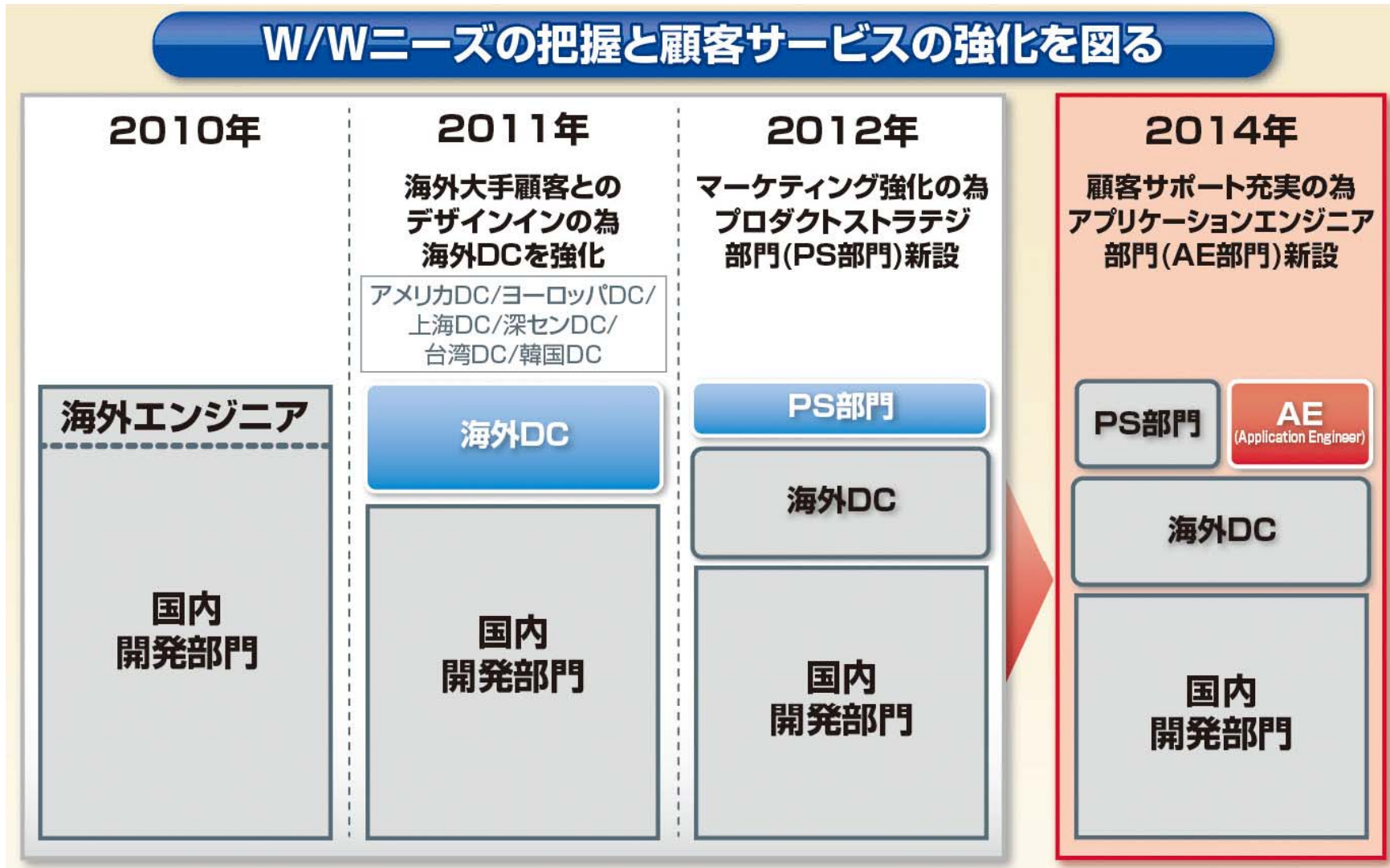
ロームの戦略

1. 市場改革 ②営業サポート体制をシフト(海外系市場)



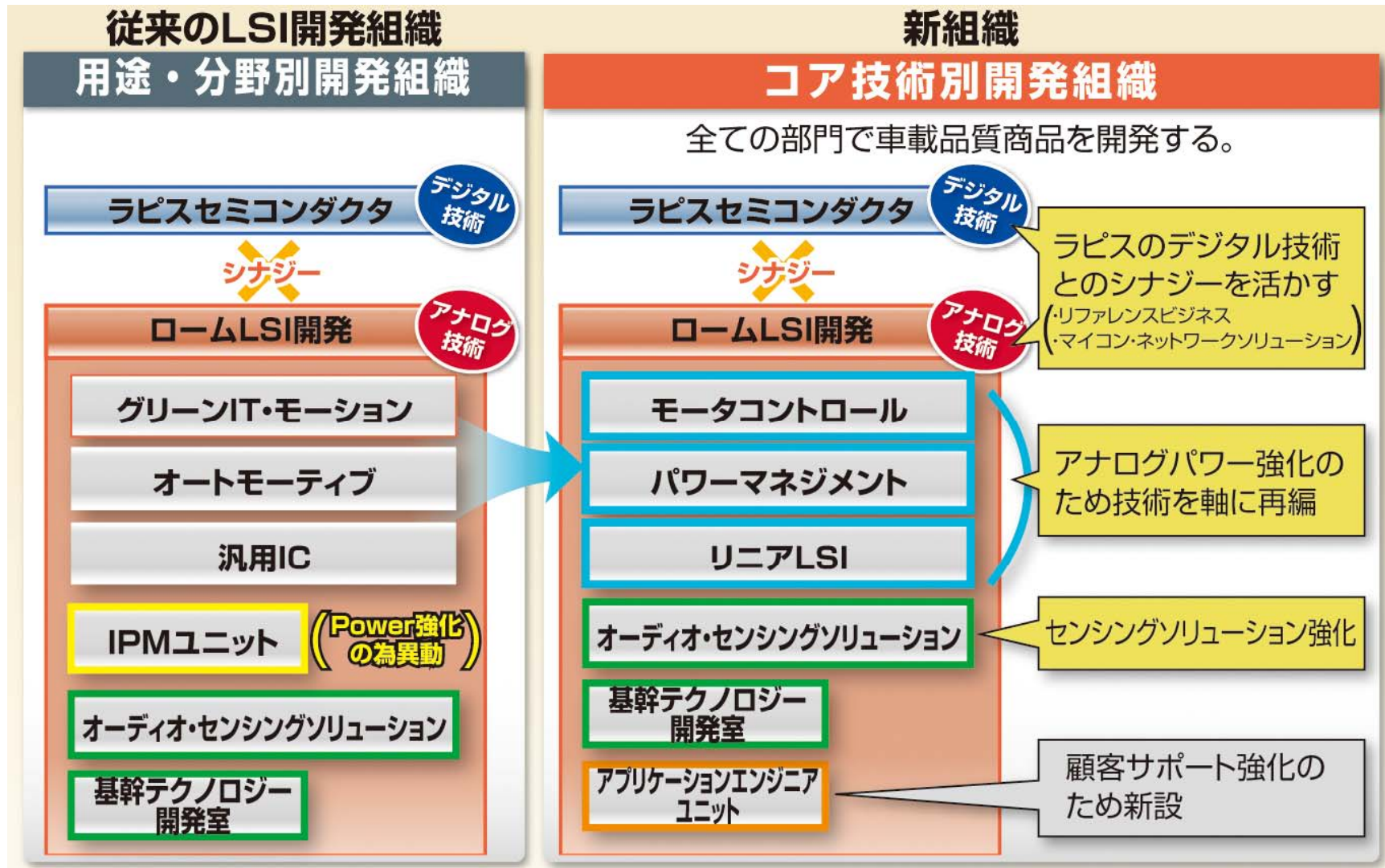
ロームの戦略

1. 市場改革 ③技術対応の強化



ロームの戦略

2. 商品改革 ① LSIアナログパワー技術を磨く



ロームの戦略

2. 商品改革 ② パワーデバイスの強化

自動車・産機分野の高いニーズに応える為、パワーデバイス製造部を新設

従来の組織

各分野別で技術を磨く

研究開発本部

SiC基礎開発

LSI商品開発本部

IPMユニット

LSI 生産本部

パワーパッケージ開発

ディスクリート生産本部

SiC製造部

パワーデバイス開発

パッケージ開発

新組織

社内のリソースを集めお客様に最適な
パワーソリューションを提供する

ディスクリートモジュール生産本部内

新設

パワーデバイス製造部

デバイス技術

SiC-SBD
SiC-MOS
Si-FRD
Si-IGBT

SiC, Siともに
ウエハから
高品質生産

モジュール技術



内作パッケージ
モジュール技術

LSI回路技術

IPM
インテリジェント
パワーモジュール



・パワー制御技術
・パワーLSI用
高耐圧プロセス

ロームの戦略

2. 商品改革 ③LEDライティングビジネス

B to Bにフォーカスしたソリューションを提供

2014年3月
量産開始

業界最高効率

190lm/W

ライバルより、さらに20%省エネ

LED × 光学設計 × 電源技術



国内直管形LEDで高いシェアをキープ



■ 国内出荷数(2012年4月~2013年3月) 4,790,376本

2014年4月

**モデルルーム
京都駅前**

OPEN



ロームのHEMSシステム

無線・センサ技術を
駆使したロームの
HEMSシステム
を提案



ロームの戦略

3. 構造改革 利益体質のさらなる強化

前工程の再編は一旦終了

- ① **ローム浜松**
300mmウエハ BiC-DMOS 0.13 μ mプロセス

2014年9月
量産
スタート

プロセスの最適化を進め、世界No.1のアナログ性能と
微細デジタル回路を1 chipで提供する

後工程の生産革新によるコストカットを追求する

- ① **世界最小デバイスへのチャレンジ(RASMID[®])**
- ② **国内マザー工場の技術力UPによる生産効率改善**
- ③ **後工程の再編による世界最適生産を実現**

ロームの戦略

4. 研究開発の取り組み

Power

更なる高電圧・大電流化により、
新たな市場を切り開く

業界最先端技術 SiC-MOS

パッケージ品 (研究品) 

モジュール品 (研究品) 

2014年4月 **耐圧4,200V達成**

2010年 世界初 

2012年 世界初 

2013年 

High Voltage

12,000V~ 送電機器 

6,600V 医療機器 

4,500V 風力発電 

3,300V 産業機器 

1,700V 電車 

1,200V EV/PHV 

600V 家電 

太陽光発電 

対応可能になる

Sensing

メディカル関連、
センサネットワーク周辺への
取り組みを強化

バナリスト

血液分析システム

量産中 単項目チップ

糖尿病 マーカー	感染症 マーカー	動脈硬化 マーカー
-------------	-------------	--------------

特許庁長官
奨励賞 

2014年3月 **腎機能マーカー開発完了**

2014年3月

今後も続々と検査項目を開発予定

*特許「マイクロ流路及びマイクロチップ」で受賞

CIGS イメージセンサ

赤外線と可視光で
皮下血管などを検知

2014年4月~
日大との医工連携スタート



Blood Vessel

脈波センサ

体表面で脈拍やHRVを
測定できる
光学センシング技術

2014年6月
ウェアラブル脈拍モニタのプロタイプ完成

生体内 

ヘモグロビン
血管

Green LED
Photo Detector

EnOcean

電源、電池、配線レス
の無線システム

2014年2月
奈良 当麻寺導入



ロームの戦略

5. 設備投資

好調なアナログパワー関連設備の増強と品質改善投資に重点

アナログパワー関連

- ・ローム浜松、12インチウエハ増強
- ・ラピス宮崎、IGBT量産体制構築
- ・RIST IPM増設 ほか

品質改善投資

- ・評価/解析装置、検査装置、全数測定機増設
- ・高信頼性ライン、車載専用ライン増設
- ・建物付帯設備更新 ほか

(単位:億円)

	合計	生産能力向上	新商品	品質向上	その他
'15/3 計画	548	232	115	71	130
比率	100%	42%	21%	13%	24%

設備投資額

前期の主な設備投資内容

LSI

ウエハ工程：本社MEMS関連増設
浜松12インチ増強
組立工程：REPI、RIST増設

半導体素子

TR/DI：生産効率改善、ウエハ大口徑
化ほか
SIC：ウエハ6インチ化

モジュール

PH：生産性改善
OPM：センサ新製品増強

その他

R：新製品ライン増設
PH：大連ライン増設、効率改善ほか

販売管理等・共通部門

本社研究設備ほか

当期の主な設備投資内容

LSI

ウエハ工程：浜松12インチ増強
本社MEMS関連増設
組立工程：RIST/REPI増設

半導体素子

ウエハ工程：アポロ8インチ増強
組立工程：RIST/REPI効率改善、
IPM増強
ラピス宮崎：IGBTほか前工程増強

モジュール

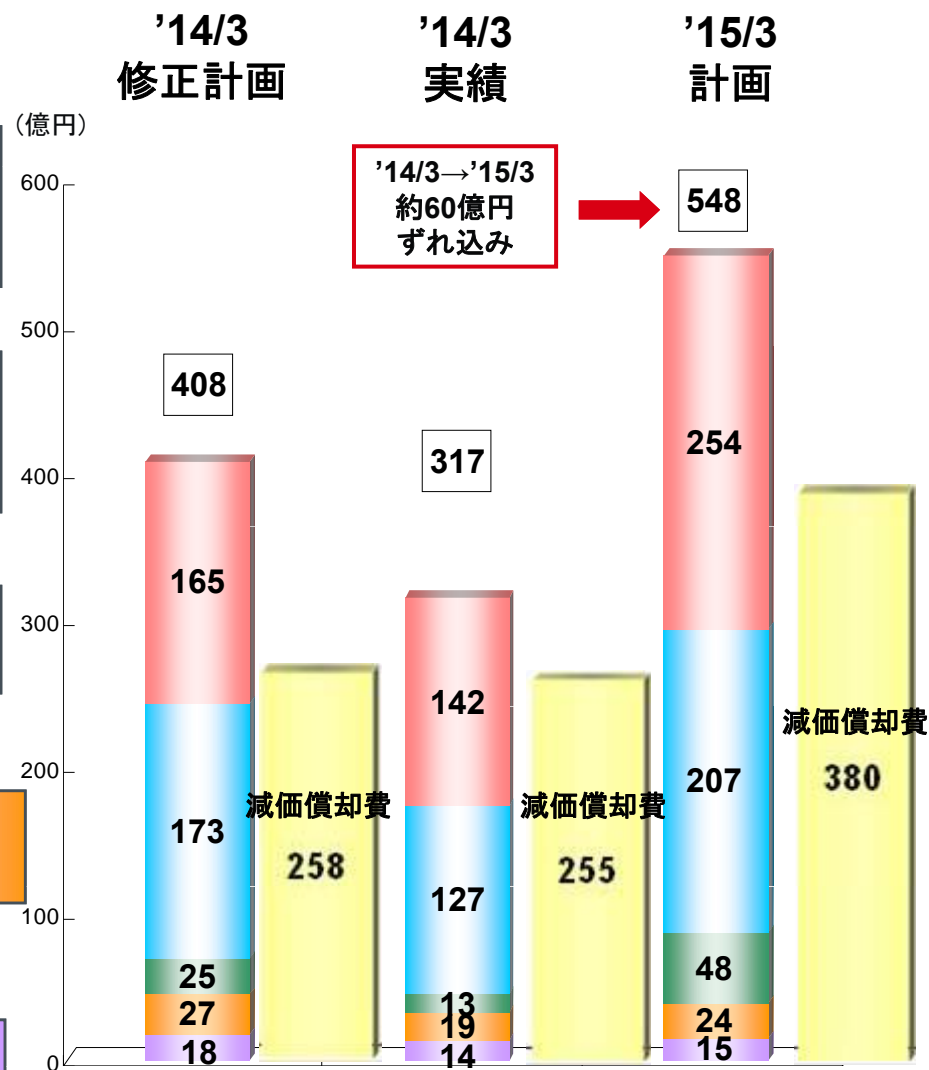
OPM：センサ増強

その他

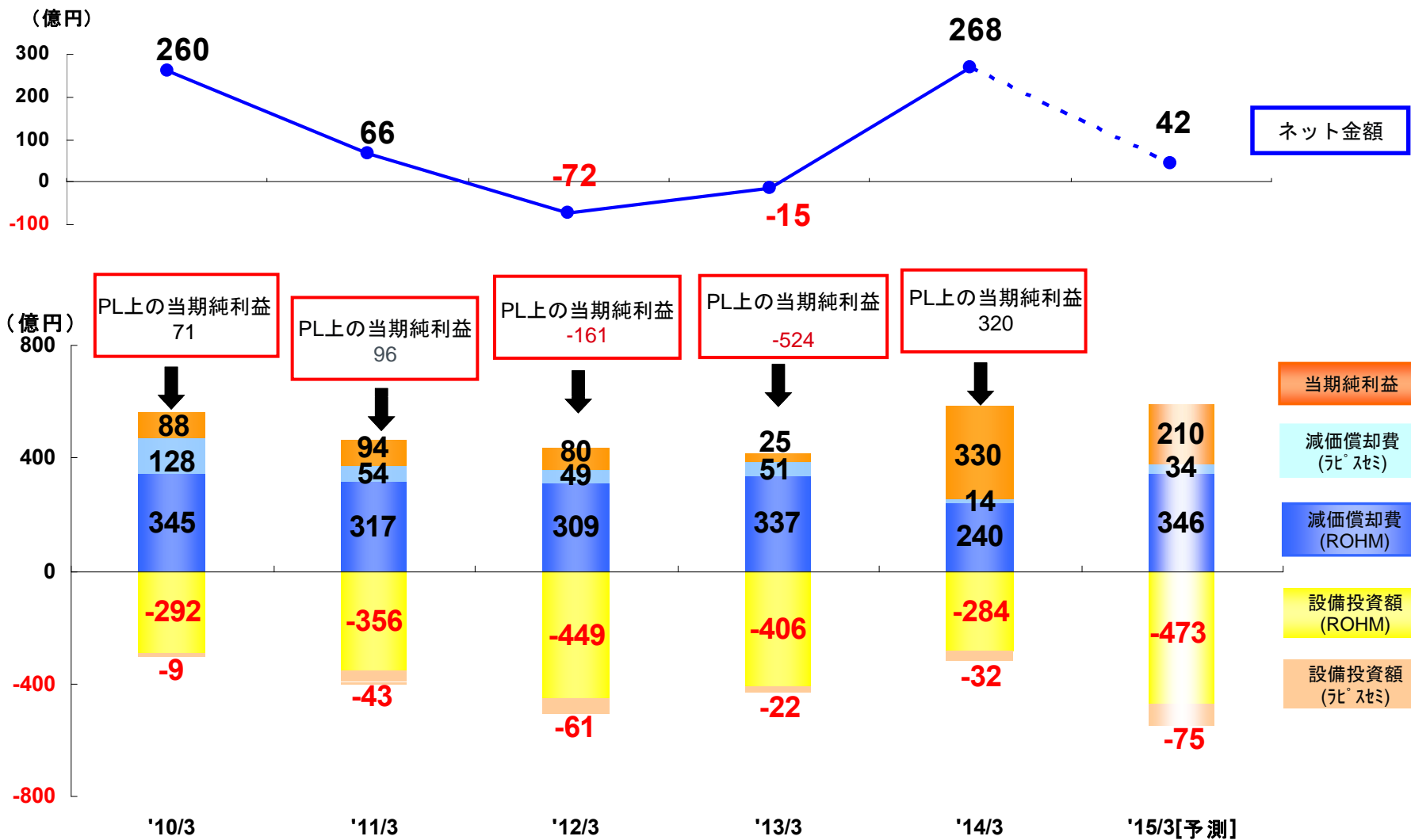
R：新製品増強ほか

販売管理等・共通部門

パワーデバイス研究設備ほか



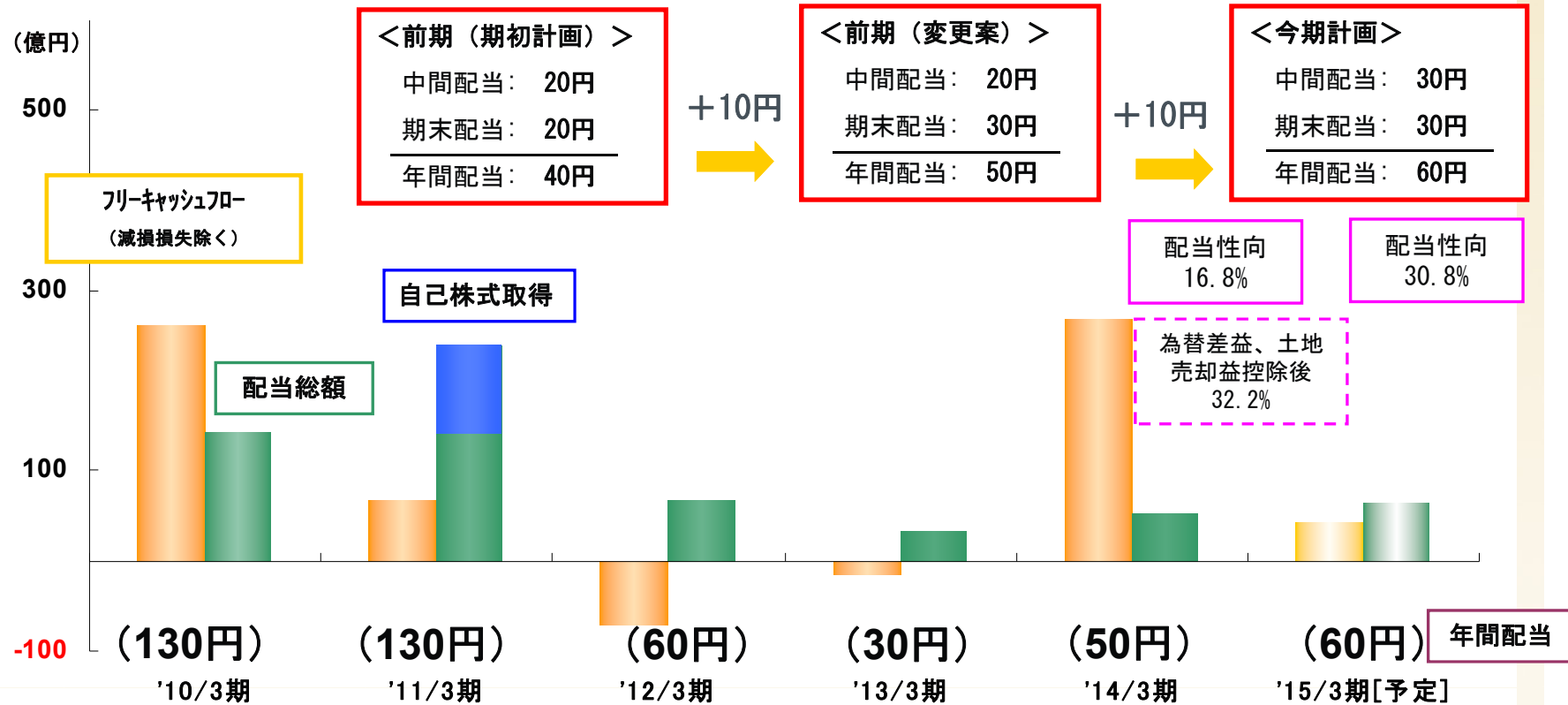
簡易キャッシュフロー (減損損失を除外)



株主還元

株主還元方針

1. 設備投資とM&Aの拡大など、事業に対する投資を優先し、中長期的な業績向上に努めます。
2. '14/3期は、期末配当金を従来計画に対して10円増加し、30円に。(年間配当:50円)
3. 今期以降の配当性向は30%以上を確保し、業績向上による株主還元の強化に努めます。



車載、産機仕様のアナログLSI製造技術基盤確立、 垂直統合の強味をフルに生かして品質、性能の差別化

1. 車載市場に注力

- 日本は情報系からボディー系、パワートレイン系、安全装置系へと採用拡大中
- 海外は情報系からサポート開始。まずは欧州市場⇒アメリカ、アジアへ水平展開

2. リファレンスビジネスをさらに強化

- プラットフォームビジネスを継続して強化
- フリースケールなど新パートナー向け開発を強化

3. センサ

- クルマとウェアラブル、モバイルにターゲット
- センサデバイスとローパワーマイコン、無線通信をトータルソリューション

ディスクリート・モジュールの事業戦略

ロームの**強い技術**にリソースを集中し、より**競争力のある事業展開**へ

従来の施策

① パワー市場向け製品の開発、
商品展開強化

② 革新的な工法による独自の超小型化、
高精度化デバイス
RASMID[®]シリーズの展開

③ 小信号個別半導体
ゆるぎないW/WシェアNo.1

今後さらに磨きをかける

① パワー戦略

- ・世界最先端SiCパワーデバイス展開強化
- ・他社にない幅広い商品展開強化
- ・ロームの技術を結集したIPMの提案

② 小信号戦略

- ・RASMID[®] 納入スタート
- ・最新鋭製造ラインへの順次切り換え
- ・リファレンスビジネスの強化

将来予測に関する注意

本資料に記載されている計画値につきましては、ロームグループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の情報に基づいており、その達成をロームグループとして約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

なお、本資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

また、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信を参照していただきますようお願いいたします。



2014年3月期